

证券简称：博敏电子

证券代码：603936

**博敏电子股份有限公司**  
**投资者关系活动记录表**

编号：2020-001

<b>投资者关系活动类别</b>	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体调研 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	金鹰基金 陈颖                      中再资产 周莹 前海行健 张韬                      中信资管 黄哲 银鸿投资 刘俊                      中意资产 臧怡 半人马座 董佳庚                    展博投资 张文敏 宇轩资本 唐运湘                    观富资产 杜渊鑫 诚元投资 周洁钰                    北信瑞丰 石础 国寿资产 杨琳                      国盛研究所 刘嘉元 鹏扬基金 王杨                      前海行健资本 卢磊 百年资管 冯轶舟                    上海于翼资产 郭晓萱 光大资管 洪紫阳                    九泰基金管理有限公司 谭劭杰 九泰基金 方向                      国盛证券研究所 马步青 信诚基金 吴振华                    汇丰晋信基金管理有限公司 朱剑胜 国金基金 吴志强                    华润元大基金管理有限公司 苏展 泓澄投资 徐哲桐
<b>时间</b>	2020年11月3日，15:30-16:30
<b>地点</b>	电话会议
<b>上市公司接待人员姓名</b>	财务总监刘远程、董事会秘书黄晓丹、证券事务专员廖鹏、证券事务专员陈思

<p style="text-align: center;">投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、活动内容： 共有两个环节：1、公司介绍；2、问答交流。</p> <p>二、交流主要内容：</p> <p>（一）公司介绍</p> <p>主要对公司的基本情况（发展历程、战略定位）、两省三地六厂的生产情况作简要介绍。</p> <p>（二）问答交流</p> <p><b>Q1：请简要介绍公司主要业务下游分布情况。</b></p> <p>A1：公司主要产品应用领域包括：消费电子、通信电子、汽车电子、工控类（如 POS 机）、军工类和安防类等。目前，收入占比较大的为消费电子、数据通信及汽车电子。</p> <p><b>Q2：公司目前对 HDI 板的市场期望及自身技术储备如何？请就目前 HDI 板的行业情况及友商情况进行简要分析？</b></p> <p>A2：HDI 板随层数及阶数的提高，生产难度逐步加大。目前，从市场需要情况来看，8~12 层的 HDI 板需求量较大，而 1~2 阶的 HDI 板产能相对紧缺。之前台资、韩资、日资 PCB 生产企业技术领先于陆资企业，近年来，随着陆资企业研发水平的提升，生产技术已比肩台资、韩资、日资 PCB 生产企业。我司从 2009 年着手布局 HDI 行业，已掌握任意阶 HDI 产品工艺并实现量产，HDI 板营收占比已超过 50%。从下游市场发展趋势来看，2019 年下半年以来，以手机为代表的智能终端对高阶 HDI 的需求迅速扩大。同时，台资和韩资 PCB 生产企业产能逐步减少，导致国内 PCB 行业产能更加紧张。考虑到目前贸易战的紧张局面，国内许多下游终端客户已将订单投向陆资企业，特别是向民营企业倾斜。在消费电子、汽车电子及新能源汽车电子领域，目前 HDI 板的需求量很高。</p> <p><b>Q3：目前来看，整个汽车市场在回暖，公司如何看待汽车板块未来对于 PCB 的需求量？公司有什么策略？</b></p> <p>A3：在国家大力发展新能源汽车的政策驱动下，未来新能源汽</p>
--	--

车的占比将不断提高，且单车的 PCB 需求量也会大幅提升，例如电控、智能互联等。在此背景下，公司对汽车电子领域做出了战略调整，提升新能源汽车产品的生产产能，加大新能源客户的开拓力度；另外在产品结构方面，新能源汽车电子用 HDI 板和软硬结合板的比重将会不断增加。此外，公司将不断加大研发力度，抢占先发优势；在工艺管控方面，公司将以一流企业为标杆，将 HDI 板和 FPC 的产能逐渐向新能源汽车电子转移，以提高公司在汽车电子领域发展的后劲。当前，公司现已成立解决方案事业群，在电阻、电感方面已经储备了一批合作伙伴。未来，公司将与下游客户通力合作，在耐高温、抗高压元器件等方面进行深度研发，迅速提升公司在汽车电子领域的核心竞争力。未来，公司不仅生产 PCB，还将生产贴片模组等，甚至可以帮客户有针对性地解决问题。

**Q4: 在高阶 HDI 生产线这一块，是否有跟设备厂商签订合同？未来会考虑国产设备厂商吗？**

A4: 公司已和相关厂商签订了合同。当前，公司激光钻孔和 LDI 设备较为紧缺，需尽快购置，为扩充产能做相应准备。公司后续会考虑国产设备厂商，也将和设备生产厂商探索新的合作模式。

**Q5: 公司目前软硬结合板的体量及技术水平是处在一个什么样的状态？相比传统软板制造商，硬板制造商在软硬结合板方面有什么不同？**

A5: 公司目前软硬结合板产能较为紧张，我们研判，整个 FPC 市场将会做一个大的结构分化，前期智能穿戴等应用领域导致软板的需求迅速提升，其中能一直保持两位数增长的只有软硬结合板。软硬结合板生产难度在于，软硬结合板使用的硬板是薄硬板，工艺管控与 HDI 类似，生产品质高的软硬结合板必须要有坚实的硬板生产工艺。前期，美资、台资、韩资 PCB 生产企业垄断了软硬结合板市场份额。公司自身具有先进的 HDI 技

	术能力，因此在软硬结合板方面，我司不存在技术障碍，也因此，公司积淀了一批优质软硬结合板客户。未来，公司软硬结合板的产量仍会不断上升，也将是我司重点发展方向之一。
日期	2020年11月3日
备注	无